

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯国际集成电路制造有限公司*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号：0981)

中芯截至二零零四年十二月三十一日止三个月业绩公布

本公司谨于今日公布截至二零零四年十二月三十一日止三个月的未经审核经营业绩。销售额由上季的 274,900,000 元增至二零零四年第四季的 291,800,000 元，增幅 6.2%。较 2004 年第三季晶圆付运增加 15.2%至 303,796 片 8 吋等值晶圆。月产能增至 120,417 片 8 吋晶圆。中芯与台积电达成协议。

以下为本公司于二零零五年三月二十九日就截至二零零四年十二月三十一日止三个月的未经审核业绩在美国报章所作的报章公布全文。

本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(1)条规定的披露责任而作出本公布。

以下为本公司于二零零五年三月二十九日就截至二零零四年十二月三十一日止三个月的未经审核业绩在美国报章所作的报章公布全文。

所有货币数字均以美元列账，除非特别指明。

报告内的财务报表数额按美国公认会计原则厘定。

中芯二零零四年第四季业绩报告

概要

- 销售额增至 291,800,000 元，较二零零四年第三季 274,900,000 元上升 6.2%。
- 较 2004 年第三季晶圆付运增加 15.2%至 303,796 片 8 吋等值晶圆。
- 月产能增至 120,417 片 8 吋晶圆。

- 中芯与台积电达成协议。

中国上海—二零零五年三月二十九日—国际主要半导体承包制造商中芯国际集成电路制造有限公司（纽约交易所：SMI；香港联交所：981）（「中芯」或「本公司」）于今日公布截至二零零四年十二月三十一日止三个月的综合经营业绩。二零零四年第四季销售额由上一季度的274,900,000元增加6.2%至291,800,000元。

本公司报告普通股持有人应占收入从二零零四年第三季盈利39,300,000元下降至本季度亏损11,200,000元，若扣除本公司与台湾積體電路製造股份有限公司的诉讼解决的相关费用23,200,000元，二零零四年第四季可录得普通股持有人应占收入11,900,000元。

电话会议／网上业绩公布详情

日期：二零零五年三月二十九日

时间：上海时间上午八时正

拨号及登入密码：美国 1-617-614-3943（密码：SMIC）或香港852-3002-1672（密码：SMIC）。

二零零四年第四季业绩公布网上直播可于 www.smics.com 网站「投资者关系」一栏收听。中芯网站在网上广播后为期十二个月提供网上广播录音版本连同本新闻发布的软拷贝。

有关中芯

中芯（纽约交易所：SMI；香港联交所：0981.HK）是全球首屈一指的半导体承包制造厂之一。作为一家半导体承包制造厂，中芯提供以0.35微米至0.13微米技术制造的集成电路。中芯成立于二零零零年四月，是一家开曼群岛公司，于中国上海张江高科技园区营运三间8吋晶圆装配厂，以及于天津营运一间8吋晶圆装配厂。此外，中芯最近在中国北京的新12吋晶圆装配厂房开始生产。为向客户提供高品质的服务，中芯国际还营运在美国、欧洲、日本的客户服务和市场销售办公室。中芯国际努力达到甚至超越各项国际标准并已获得ISO9001, ISO/TS16949, OHSAS18001和ISO14001国际认证。其它资料详情，请浏览www.smics.com。

安全港声明

（根据1995私人有价证券诉讼改革法案）

本次新闻发布可能载有（除历史资料外）依据1995私人有价证券诉讼改革法案所界定的「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述乃根据中芯对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯使用「相信」、「预期」、「计划」、「估」、「预计」、「预测」及类似表述为该等前瞻性陈述之标识，为并非所有前瞻性陈述均包含上述字眼。该等前瞻性陈述乃反映中芯高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知风险、不确定性，以及其它可能导致中芯实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料存在重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场状况有关的风险、激烈竞争、中芯客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯量产新产品的能力、半导体承包制造服务供求情况、市场产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造生产量供给及最终市场的金融局势是否稳定。

投资者应考虑中芯呈交予美国证券交易委员会（「证交会」）的文件资料，包括其于二零零四年三月十一日以F-1表格（经修订）形式呈交予证交会的登记声明，特别是「风险因素」及「有关财务状况及经营业绩的管理层讨论及分析」两个部份、其于二零零四年三月八日以A-1表格形式呈交予香港联合交易所（「香港联交所」）的登记声明，以及中芯可能不时向证交会及香港联交所呈交的该等其它文件，包括6-K表格。其它未知或不可逆料的因素亦可能会

对中芯日后的业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于上述风险、不确定性、假设及因素，本新闻发布中提及的前瞻性事件可能不会发生。务请阁下注意，切勿过份依赖此等前瞻性陈述，此等陈述仅就本新闻发布中所载述日期（或如无有关日期，则本新闻发布日期）的情况而表述。

除法律有所规定以外，中芯概不就因新资料、未来事件或其它原因引起的任何情况承担任何责任，亦不拟更新任何前瞻性陈述。

投资者联络资料：

Jimmy Lai

投资者关系部负责人

电话：86-21-5080-2000，内线 16088

传真：86-21-5080-3070

Calvin Lau

投资者关系部

电话：86-21-5080-2000，内线 16693

传真：86-21-5080-3070

Evonne Hwang

投资者关系部

电话：86-21-5080-2000，内线 16275

传真：86-21-5080-3070

概要：

以千美元为单位（每股盈利除外）

	<u>二零零四年</u> <u>第四季度</u>	<u>二零零四年</u> <u>第三季度</u>	<u>季度比较</u>	<u>二零零三年</u> <u>第四季度</u>	<u>年度比较</u>
销售	291,842	274,897	6.2%	145,047	101.2%
销售成本	232,725	202,387	15.0%	114,333	103.5%
毛利	59,117	72,510	-18.5%	30,714	92.5%
经营开支	82,505	29,972	175.3%	26,096	216.2%
经营溢利	(23,388)	42,538	-	4,617	-
其它收入	12,358	(3,195)	-	6,260	97.4%
收入（亏损）净额	(11,216)	39,343	-	10,877	-
视为优先股派付的股息	-	-	-	(2,531)	-100.0%
普通股持有人应占收入	(11,216)	39,343	-	8,346	-
毛利率	20.3%	26.4%		21.2%	
经营利润率	-8%	15.5%		3.2%	
每股基本盈利—每股普通股 1)	\$ (0.0006)	\$0.0022		\$0.0867	
每股基本盈利—每股美国预托股份	\$ (0.0311)	\$0.1095		\$4.3334	
每股摊薄盈利—每股普通股	\$ (0.0006)	\$0.0022		\$0.0005	
每股摊薄盈利—每股美国预托股份	\$ (0.0311)	\$0.1079		\$0.0268	
付运晶圆（8吋等值）(2)	303,796	263,808	15.2%	153,125	98.4%
综合平均售价	\$917	\$991	-7.5%	\$910	0.8%
逻辑平均售价(3)	\$1,020	\$1,091	-6.5%	\$967	5.5%
产能使用率	95%	99%		97%	

附注：

(1) 基于二零零四年第四季加权平均普通股 18,006,000,000 股，二零零四年第三季 17,897,000,000 股和二零零三年第四季 96,000,000 股。

(2) 包括铜接连件

(3) 不包括铜接连件

- 销售额增至 291,800,000 元，较二零零四年第三季的 274,900,000 元录得季度升幅 6.2%，并较二零零三年第三季的 145,000,000 元录得年度升幅 101.2%。导致此等上升的主要因素如下：

- 二零零四年第四季末产能增加至 120,417 片 8 吋晶圆；

- 晶圆付运增至 303,796 片，较二零零四年第三季的 263,808 片录得季度升幅 15.2%；
- 95%的高使用率
- 销售成本从上季的 202,400,000 元增加到 232,700,000 元，主要由于晶圆付运增加，折旧费用增加，由于市场预期价值的下调引起的存货市场价值下调。
- 毛利降至 59,100,000 元，较二零零四年第三季的 72,500,000 元录得季度降幅 18.5%并较二零零三年第四季的 30,700,000 元录得年度升幅 92.5%。
- 毛利率从二零零四年第三季的 26.4%降至 20.3%，主要是由于折旧费用的增加和由于 DRAM 市价普遍下降以及 0.35 微米晶圆的生产量增加共同造成的综合 ASP 的下降。
- 研发费用增加至 27,400,000 元，较上季的 20,700,000 元上升 32.5%，主要来自 90 纳米的研究开发活动，北京四厂非经常性工程开业成本以及折旧费用的增加。
- 一般行政费用(不包括汇兑损益)从二零零四年第三季 10,300,000 元上升至二零零四年第四季的 14,200,000 元。主要由于与台积电诉讼费用的增加。
- 一般行政费用(包括汇兑损益)从二零零四年第三季 3,800,000 元上升 564.9%至 25,500,000 元，差额主要因与经营活动（如应收账款或应付账款）相关的汇兑损失 11,300,000 元。
- 二零零四年第四季度销售及市场推广费用较二零零四年第三季的 1,900,000 元增至 2,500,000 元，录得季度升幅 33.9%，主要由于与销售活动相关的材料费用的上升。
- 二零零四年第四季录得诉讼解决费用 23,200,000 元。
- 经营溢利由二零零四年第三季的盈利 42,500,000 元降至亏损 23,400,000 元，二零零三年第四季为盈利 4,600,000 元。
- 其它非营业性溢利由二零零四年第三季的亏损 3,200,000 元上升为第四季的盈利 12,400,000 元。主要是因与融资或投资活动（如远期合约归类为其它业务收入/支出）相关的非经营性活动产生的汇兑收益 13,300,000 元。
- 汇兑净收益为 2,000,000 元，其中一般行政费用中包括了汇兑损失 11,300,000 元。与融资或投资活动相关的非经营性活动产生的汇兑收益 13,300,000 元归类为其它经营性溢利。
- 二零零四年第四季扣除收入所得税后的净损失由二零零四年第三季的盈利 39,300,000 元和二零零三年第四季的盈利 10,900,000 元降至净损失 11,200,000 元。

1. 收入分析

销售分析					
以应用分类	<u>二零零四年</u> 第四季	<u>二零零四年</u> 第三季	<u>二零零四年</u> 第二季	<u>二零零四年</u> 第一季	<u>二零零三年</u> 第四季
计算机	26.8%	20.5%	22.5%	25.1%	26.7%
通讯	58.1%	57.2%	54.3%	56.0%	55.8%
消费	10.2%	17.1%	17.1%	12.7%	13.5%
其它	4.9%	5.2%	6.1%	6.2%	4.0%
以装置分类	<u>二零零四年</u> 第四季	<u>二零零四年</u> 第三季	<u>二零零四年</u> 第二季	<u>二零零四年</u> 第一季	<u>二零零三年</u> 第四季
逻辑（包括铜接件）	75.1%	77.6%	73.5%	72.4%	71.6%
DRAM（1）	20.4%	17.5%	20.8%	21.6%	24.5%
其它（光罩制造及探测）	4.5%	4.9%	5.7%	6.0%	3.9%
以客户类别分类	<u>二零零四年</u> 第四季	<u>二零零四年</u> 第三季	<u>二零零四年</u> 第二季	<u>二零零四年</u> 第一季	<u>二零零三年</u> 第四季
非厂房半导体公司	50.2%	35.3%	36.1%	36.6%	30.8%
集成装置制造商	47.5%	56.3%	54.8%	54.0%	62.7%
系统公司及其它	2.3%	8.4%	9.1%	9.4%	6.5%
以地区分类	<u>二零零四年</u> 第四季	<u>二零零四年</u> 第三季	<u>二零零四年</u> 第二季	<u>二零零四年</u> 第一季	<u>二零零三年</u> 第四季
北美洲	34.9%	41.8%	44.0%	41.4%	36.2%
亚太区（不包括日本）	43.5%	31.5%	26.5%	27.2%	28.6%
日本	8.8%	15.6%	16.2%	16.3%	15.5%
欧洲	12.8%	11.1%	13.3%	15.1%	19.7%
晶圆收入分析					
以技术分类 （仅包括逻辑、记忆及铜连接件）	<u>二零零四年</u> 第四季	<u>二零零四年</u> 第三季	<u>二零零四年</u> 第二季	<u>二零零四年</u> 第一季	<u>二零零三年</u> 第四季
0.13 微米	13.8%	11.9%	9.9%	10.1%	10.4%
0.15 微米	14.9%	13.2%	13.3%	15.7%	17.5%
0.18 微米	33.6%	46.2%	48.6%	44.4%	34.7%
0.25 微米	6.0%	6.4%	8.3%	8.3%	10.6%
0.35 微米	31.7%	22.3%	19.9%	21.5%	26.8%

以逻辑分类 (2)	二零零四年	二零零四年	二零零四年	二零零四年	二零零三年
	第四季	第三季	第二季	第一季	第四季
0.13 微米	2.4%	1.8%	0.9%	0.0%	0.0%
0.15 微米	5.3%	4.6%	3.9%	4.4%	1.9%
0.18 微米	38.2%	56.2%	63.0%	58.5%	52.9%
0.25 微米	7.8%	6.1%	3.1%	5.0%	3.4%
0.35 微米	46.3%	31.3%	29.1%	32.1%	41.8%

附注：

(1) 先前所用的是“记忆体”一词，但是所有历史报告在这个类别中都仅仅包括 DRAM 装置。

(2) 不包括 0.13 微米铜接连件

- 相较二零零四年第三季而言，二零零四年第四季电脑类别的销售额较其它应用技术增长更快。
- 二零零四年第四季逻辑晶圆(包括铜接连件) 的销售百分比下降至占销售额的 75.1%，二零零四年第三季则为 77.6%。
- 非厂房半导体公司占二零零四年第四季销售额 50.2%，二零零四年第三季则为 35.3%。
- 二零零四年第三季源自亚太客户（不包括日本）的销售百分比上升至 43.5%，二零零四年第三季度则为 31.5%。
- 二零零四年第四季 0.18 微米及以下技术的销售百分比占销售额下降至 62.3%，二零零四年第三季度为 71.3%。

产能：

期终每月晶圆计，8 吋等值

厂 / (晶圆尺寸)	二零零四年第四季	二零零四年第三季
一厂 (8 吋)	45,536	38,820
二厂 (8 吋)	35,870	34,824
四厂 (12 吋)	7,027	-
七厂 (8 吋)	14,182	10,322
每月晶圆装配总产能	102,615	83,966

铜接连件：		
三厂（8吋）	17,802	15,077
每月铜接连件总产能	17,802	15,077

注（1）本期末晶圆产量

截至二零零四年第四季度终结时，每月产能增加至 120,417 件晶圆。

付运及使用率：

<u>8吋晶圆</u>	<u>二零零四年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>二零零三年</u>
	<u>第四季</u>	<u>第三季</u>	<u>第二季</u>	<u>第一季</u>	<u>第四季</u>
付运晶圆（包括铜接连件）	303,796	263,808	201,534	174,325	153,125
使用率 ⁽¹⁾	95%	99%	99%	99%	97%

附注：

(1) 使用率按输出晶圆总额除以估计产能计算

- 二零零四年第四季晶圆付运量为 303,796 件 8 吋等值晶圆，分别较二零零四年第三季的 263,808 片及二零零三年第四季度的 153,125 片上升 15.2% 及 98.4%。
- 使用率下降至 95%。

综合平均售价趋势

逻辑平均售价趋势 （不包括 0.13 微米铜接连件）

二零零四年第四季综合平均售价分别由二零零四年第三季的 991 元下降至 917 元，主要原因在于本公司生产更多成熟的逻辑晶圆以及 DRAM 的价格普遍下降。

二零零四年第四季逻辑平均售价（不包括 0.13 微米铜接连件）由二零零四年第三季的 1,091 元下降至 1,020 元。主要原因在于本公司转而生产更多成熟的逻辑晶圆。

2. 详细财务分析

毛利分析

<u>以千美元计</u>	<u>二零零四年</u> 第四季	<u>二零零四年</u> 第三季	<u>季度比较</u>	<u>二零零三年</u> 第四季	<u>年度比较</u>
销售成本	232,725	202,387	15.0%	114,333	103.5%
折旧和摊销	130,839	108,254	20.9%	51,957	151.8%
其它制造成本	101,886	94,173	8.2%	63,377	63.3%
毛利	59,117	72,510	(18.5%)	30,714	92.5%
毛利率	20.3%	26.4%		21.2%	

- 销售成本从上季的 202,400,000 元增加到 232,700,000 元，主要由于晶圆付运增加，折旧费用增加，由于市场预期价值的下调引起的存货市场价值下调。
- 毛利降至 59,100,000 元，较二零零四年第三季的 72,500,000 元录得季度降幅 18.5%，二零零三年第四季的 30,700,000 元录得年度升幅 92.5%。
- 毛利率从二零零四年第三季的 26.4% 降至 20.3%，主要是由于折旧费用的增加和由于 DRAM 市价普遍下降以及 0.35 微米晶圆的生产量增加共同造成的综合 ASP 的下降。

经营开支分析

<u>以千美元计</u>	<u>二零零四年</u> 第四季	<u>二零零四年</u> 第三季	<u>季度比较</u>	<u>二零零三年</u> 第四季	<u>年度比较</u>
总经营开支	82,505	29,972	175.3%	26,096	216.2%
研究及开发	27,407	20,688	32.5%	9,341	193.4%
一般及行政	25,476	3,831	564.9%	12,251	108.0%
销售及市场推广	2,544	1,899	33.9%	2,269	12.1%
诉讼解决	23,153	-	-	-	-
递延股份报酬摊销	3,925	3,554	10.5%	2,235	75.6%

- 总经营开支上升至 82,500,000 元，较二零零四年第三季的 30,000,000 元录得季度升幅 175.3%，并较二零零三年第四季的 26,100,000 元录得年度升幅 216.2%。
- 研究及开发费用上升至 27,400,000 元，较上季的 20,700,000 元录得季度升幅 32.5%，主要由于 90 纳米的研究开发活动 北京四厂非经常性工程开业成本增长和折旧费用的增加所致。

- 一般行政费用（不包括汇兑损益）从二零零四年第三季度的 10,300,000 元上升至二零零四年第四季的 14,200,000 元。主要由于与台积电诉讼费用的增加。
- 一般行政费用(包括汇兑损益)从二零零四年第三季 3,800,000 元上升 564.9%至 25,500,000 元，差额主要因与经营活动（如应收账款或应付账款）相关的汇兑损失 11,300,000 元。
- 销售和市场营销费用从二零零四年第三季 1,900,000 元上升了 33.9%至二零零四年第四季 2,500,000 元，主要由于销售活动相关的材料费用的上升。
- 二零零四年第四季录的诉讼解决 23,200,000 元。

非经营收入（支出）

<u>以千美元计</u>	<u>二零零四年</u> <u>第四季</u>	<u>二零零四年</u> <u>第三季</u>	<u>季度比较</u>	<u>二零零三年</u> <u>第四季</u>	<u>年度比较</u>
其它收入(支出)	12,358	(3,195)	-	6,260	97.4%-
利息收入	3,264	3,106	5.0%	2,983	9.4%
利息支出	(4,581)	(3,614)	26.7%	(926)	394.9%
其它，净额	13,675	(2,687)	-	4,203	225.4%
视为优先股派付的股息	-	-	-	(2,531)	-100.0%

- 二零零四年第四季其它非营业性收入 12,400,000 元主要是因与融资或投资活动（如远期合约）归类为其他业务收入/支出相关的非经营性活动产生的汇兑收益 13,300,000 元。

3. 流动资金

<u>以千美元计</u>	<u>二零零四年第四季</u>	<u>二零零四年第三季</u>
现金及现金等价物	607,173	950,165
短期投资	20,364	90,823
应收账款	169,188	187,235
存货	144,018	134,757
其它	14,675	33,371
总流动资产	955,418	1,396,351
应付账款	364,334	717,756
长期借款的即期部份	191,986	191,984
其它	174,010	85,245
总流动负债	730,330	994,985

现金比率	0.8x	1.0x
速动比率	1.1x	1.3x
流动比率	1.3x	1.4x

- 现金及现金等价物由 950,200,000 元降至 607,200,000 元，主要由于资本开支所致。

应收账款/存货的各日走势

资本结构

<u>以千美元计</u>	<u>二零零四年第三季</u>	<u>二零零四年第二季</u>
现金及现金等价物	607,173	950,165
短期投资	20,364	90,823
短期借款	91,000	20,000
长期借款的即期部份	191,986	191,984
长期借款	544,462	544,454
总借款	827,448	756,438
现金净额	(199,911)	284,550
股东权益	3,109,484	3,112,912
总借款对权益比率	26.6%	24.3%

- 总借款由二零零四年第三季的 756,400,000 元增至二零零四年第四季的 827,400,000 元，主要是由于短期借款增加。

- 总借款对权益比率由二零零四年第三季的 24.3% 上升至二零零四年第四季的 26.6%。

4. 现金流量及资本开支

<u>以千美元计</u>	<u>二零零四年第四季</u>	<u>二零零四年第三季</u>
收入净额	(11,216)	39,343
折旧及摊销	148,271	122,636
购入固定资产	(643,069)	(617,011)
所购无形资产摊销	4,092	3,508
现金变动净额	(342,992)	(248,428)

资本开支计划

- 二零零四年资本开支约为 2,000,000,000 元。
- 计划下的二零零五年资本开支约为 1,000,000,000 元，并且根据市场情况有所调整。

5. 二零零五年第一季指引

- 晶圆付运预期下降 5% - 7%。
- 使用率预计下降约至 85%。
- 综合 ASP 预计与上季相比下降 11%-13%。
- 毛利率预计为较小正数。
- 经营开支相对销售的百分比预计为 14%至 15%。
- 资本开支约为 350,000,000 - 360,000,000 元。
- 折旧及摊销约为 170,000,000 元至 180,000,000 元。
- 递延补偿开支约为 7,000,000 元，其中约 4,000,000 元将于经营开支中扣账及销售成本为 3,000,000 元。

6. 近期公布

- 中芯国际通过 TL9000 电信业质量管理体系认证（二零零五年三月二十一日）
- 中芯国际与苏州国芯签署合作协议（二零零五年三月十七日）
- 中芯国际参与 SEMICON China 2005 的系列活动（二零零五年三月十五日）
- 扩展一站式服务能力，中芯国际提供凸块服务（二零零五年三月四日）
- 畅讯科技与中芯国际签订合作协议（二零零五年二月二十八日）
- 中芯截至二零零四年十二月三十一日止三个月销售额发布（二零零五年一月三十一日）
- 中芯国际与台积电达成协议（二零零五年一月三十日）
- 中芯国际更新二零零四年第四季度指引。（二零零四年十二月二十二日）

- 上海方泰与中芯国际签订战略合作协议。（二零零四年十二月九日）
- 芯原为凯明 3G TD-SCDMA 芯片提供后端设计服务，使用中芯国际 0.18 微米工艺制程一次流片成功。（二零零四年十二月八日）

上述公布详情请参阅中芯网站 www.smics.com。

中芯财务资料

合并资产负债表
(美元)

截至以下日期止三个月

资产负债表

	二零零四年十二月三十一日 (未经审核)	二零零四年九月三十日 (未经审核)
资产		
流动资产:		
现金及现金等价物	607,172,570	950,164,909
短期投资	20,364,184	90,823,297
应收账款, 已扣除拨备 (二零零四年十二月三十一日为 1,105,165 元, 二零零四年九月三十日为 421,681 元)	169,188,287	187,235,125
存货	144,017,852	134,757,006
预付款项及其它流动资产	12,842,994	8,495,044
待售资产	1,831,972	24,875,320
流动资产合计	955,417,859	1,396,350,701
土地使用权, 净额	39,197,774	34,630,167
物业、厂房及设备总额	4,084,340,793	3,785,221,468
累计折旧	(772,416,194)	(623,572,186)
物业、厂房及设备, 净额	3,311,924,599	3,161,649,282
购入无形资产, 净额	77,735,299	59,720,325
资产合计	4,384,275,531	4,652,350,474
负债及股东权益		
流动负债:		
应付账款	364,333,613	717,756,459
预提费用及其它流动负债	82,857,551	65,244,711
短期借款	91,000,000	20,000,000
长期借款的即期部份	191,986,372	191,983,707
应付所得税	152,000	-
流动负债合计	730,329,536	994,984,877

长期负债：		
长期借款	544,462,074	544,453,946
长期负债合计	544,462,074	544,453,946
负债合计	1,274,791,610	1,539,438,823
承诺		
股东权益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份为 50,000,000,000 股，截止二零零四年十二月三十一日已发行股份为 18,232,179,139 股，未发行的股份为 18,228,120,120 股。	7,292,872	7,291,249
认股权证	32,387	50,297
额外缴入股本	3,289,724,885	3,291,017,646
应收股东票据	(391,375)	(876,911)
累计其它综合盈余	387,776	776,915
递延股票报酬	(51,177,675)	(60,178,603)
累计亏绌	(136,384,949)	(125,168,942)
所有股东权益合计	3,109,483,921	3,112,911,651
总负债及股东权益合计	4,384,275,531	4,652,350,474

合并营运报表
(美元)

截至以下日期止三个月

	二零零四年十二月三十一日 (未经审核)	二零零四年九月三十日 (未经审核)
销售额	291,841,924	274,897,225
销售成本	229,573,732	199,163,928
销售成本—摊销递延股票报酬	3,151,575	3,223,528
毛利	59,116,617	72,509,769
经营费用:		
研究和开发	27,406,568	20,688,265
一般管理	25,476,267	3,831,441
销售和市场推广	2,543,654	1,899,002
诉讼费用	23,153,105	-
摊销递延股票报酬*	3,925,186	3,553,558
经营费用总额	82,504,780	29,972,266
经营收入	(23,388,163)	42,537,503
其它收入(支出):		
利息收入	3,263,727	3,107,173
利息支出	(4,580,725)	(3,614,187)
其它净额	13,675,198	(2,687,195)
其它净收入	12,358,200	(3,194,209)
所得税前净收入(亏损)	(11,029,963)	39,343,294
所得税-当前	186,044	-
净收入(亏损)	(11,216,007)	39,343,294

每股股份收入净额，基本	(0.0006)	0.0022
每股美国预托股份收入净额，基本(1)	(0.0311)	0.1095
每股股份收入净额，摊薄	(0.0006)	0.0022
每股美国预托股份收入 净额，摊薄(1)	(0.0311)	0.1079
用作计算基本每股收入 净额的股份（以百万计）	18,006	17,961
用作计算摊薄每股收入 净额的股份（以百万计）	18,006	18,225
* 摊销递延股票报酬乃关于：		
研究和开发	1,175,503	1,346,112
一般和管理	2,289,305	1,667,791
销售及市场推广	460,378	539,655
总计	<u>3,925,186</u>	<u>3,553,558</u>

(1) 一股美国预托股份等于 50 股普通股。

合并现金流量表 (美元)

	截至以下日期止三个月	
	二零零四年 十二月三十一日 (未经审核)	二零零四年 九月三十日 (未经审核)
经营活动		
普通股持有人应占收入	(11,216,007)	39,343,294
视为已派付优先股股息	-	-
收入净额	<u>(11,216,007)</u>	<u>39,343,294</u>
收入净额至经营活动所得(所耗)现金净额对账的调整:		
出售厂房及设备的收益	(69,916)	(486,231)
呆账拨备	683,484	64,855
折旧及摊销	148,271,100	122,635,996
摊销购入无形资产	4,091,723	3,507,555
摊销递延股票报酬	7,076,761	6,777,086
营运资产及负债的变动:		
应收账款	17,363,354	(55,592,431)
存货	(9,260,846)	(21,194,466)
预付款及其它流动资产	(5,852,079)	115,508
应付账款	5,602,323	8,805,299
应付所得税	152,000	-
预提费用及其它流动负债	1,312,002	15,264,958
经营活动所得现金净额	<u>158,153,899</u>	<u>119,241,423</u>
投资活动		
购买厂房及设备	(643,069,258)	(617,011,320)
购买购入无形资产	(3,967,841)	(728,529)
出售短期投资	69,933,387	-
待售资产已收款项	3,158,817	3,025,118
出售厂房及设备收到款项	868,000	52,196

投资活动所耗现金净额	(573,076,895)	(614,662,535)
融资活动		
短期借款所得款项	71,010,793	20,000,000
长期借款所得款项	-	226,480,618
行使雇员购股权所得款项	297,743	495,772
收取应收认购款项	485,536	—
融资活动所得现金净额	71,794,072	246,976,390
汇率变动的影晌	136,585	17,208
现金及现金等价物减少净额	(342,992,339)	(248,427,514)
现金及现金等价物—二零零四年十月一日	950,164,909	1,198,592,423
现金及现金等价物—二零零四年十二月三十一日)	607,172,570	950,164,909

于本公布刊发日期，本公司董事分别有董事会主席及执行董事张汝京、非执行董事蔡来兴、姚方（蔡来兴的替任董事）、独立董事徐大麟、周延鹏、川西刚、萧崇河、陈立武及王阳元。

承董事会命
中芯国际集成电路制造有限公司
主席
张汝京
香港，二零零五年三月二十九日

* 仅供识别